



## 2023年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2022年8月8日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 松村 晃文

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2022年8月10日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2023年3月期第1四半期の連結業績(2022年4月1日～2022年6月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第1四半期	473,654	4.8	117,519	17.1	117,692	17.5	88,095	12.2
2022年3月期第1四半期	452,049	43.6	141,791	92.0	142,630	89.9	100,363	77.8

(注) 包括利益 2023年3月期第1四半期 83,582百万円 (24.5%) 2022年3月期第1四半期 110,712百万円 (60.1%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第1四半期	565.59	562.98
2022年3月期第1四半期	645.20	641.70

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2023年3月期第1四半期	1,846,911	1,314,847	70.4
2022年3月期	1,894,457	1,347,048	70.5

(参考) 自己資本 2023年3月期第1四半期 1,300,108百万円 2022年3月期 1,335,152百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期		643.00		760.00	1,403.00
2023年3月期					
2023年3月期(予想)		751.00		927.00	1,678.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	1,100,000	18.0	319,000	16.1	319,000	14.8	234,000	16.9	1,502.29
通期	2,350,000	17.3	716,000	19.5	716,000	19.0	523,000	19.7	3,357.63

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

## 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、[添付資料]9ページ「2.四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2023年3月期1Q	157,210,911 株	2022年3月期	157,210,911 株
------------	---------------	----------	---------------

期末自己株式数

2023年3月期1Q	1,443,724 株	2022年3月期	1,461,581 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2023年3月期1Q	155,756,620 株	2022年3月期1Q	155,555,388 株
------------	---------------	------------	---------------

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2023年3月期1Q 610,472株、2022年3月期 610,529株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

## 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]4ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2022年8月8日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) キャッシュ・フローに関する説明	4
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	9
(セグメント情報等)	10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間の世界経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う一部地域でのロックダウンによるサプライチェーンへの影響、地政学リスクの高まりによる資源価格の高騰、欧米諸国を中心とした政策金利の引き上げ、為替変動などの影響が見られました。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、半導体の重要性が高まっており、半導体製造装置市場は中長期的な成長が見込まれております。

このような状況のもと、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,736億5千4百万円(前年同期比4.8%増)、営業利益1,175億1千9百万円(前年同期比17.1%減)、経常利益1,176億9千2百万円(前年同期比17.5%減)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は880億9千5百万円(前年同期比12.2%減)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

#### ① 半導体製造装置

ロジック/ファウンドリ向け半導体に対する設備投資は、社会のデジタル化を背景に、最先端から成熟世代まで広い範囲で投資がおこなわれました。また、DRAM及びNANDフラッシュメモリ向けの設備投資も堅調に推移しました。

このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、4,640億3百万円(前年同期比6.0%増)となりました。

#### ② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

テレビ用大型液晶パネル向け設備投資が一巡したことにより、FPD TFTアレイ向け製造装置市場全体としては減速傾向となりました。一方、中小型有機ELパネル向け設備投資については、最終製品に搭載されるディスプレイが液晶から有機ELへと転換されることに伴う投資が継続しました。

このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、96億1千4百万円(前年同期比31.8%減)となりました。

#### ③ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、3千6百万円(前年同期比2.4%増)となりました。

(ご参考)

## 【連結業績】

(単位：百万円)

	前期通期	前期				当期第1Q
		前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	
売上高	2,003,805	452,049	480,464	506,474	564,817	473,654
半導体製造装置	1,943,843	437,924	467,838	488,802	549,278	464,003
日本	228,902	54,861	53,965	63,147	56,927	42,022
北米	268,065	43,911	61,897	76,893	85,363	67,325
欧州	107,954	13,411	20,309	17,062	57,170	56,526
韓国	377,767	95,304	93,507	93,040	95,914	85,172
台湾	359,225	62,853	102,548	87,494	106,330	96,816
中国	513,529	153,684	108,825	132,217	118,803	94,086
東南アジア他	88,398	13,897	26,785	18,946	28,768	22,055
FPD製造装置	59,830	14,090	12,592	17,640	15,507	9,614
その他	131	35	32	32	31	36
営業利益	599,271	141,791	132,855	156,044	168,579	117,519
経常利益	601,724	142,630	135,131	155,618	168,344	117,692
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	437,076	100,363	99,856	110,026	126,830	88,095

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ487億3千4百万円減少し、1兆3,599億6千9百万円となりました。主な内容は、未収消費税等の減少792億7千3百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少519億9千9百万円、棚卸資産の増加833億6千1百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から152億6千4百万円増加し、2,383億4千2百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から20億6千2百万円増加し、246億3百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から161億3千9百万円減少し、2,239億9千6百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から475億4千6百万円減少し、1兆8,469億1千1百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ186億6千3百万円減少し、4,499億1千5百万円となりました。主として、未払法人税等の減少702億8千4百万円、前受金の増加526億7千4百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ33億1千8百万円増加し、821億4千7百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ322億1百万円減少し、1兆3,148億4千7百万円となりました。主として、前期の期末配当1,188億3千3百万円の実施による減少、親会社株主に帰属する四半期純利益880億9千5百万円を計上したことによる増加によるものであります。この結果、自己資本比率は70.4%となりました。

## (3) キャッシュ・フローに関する説明

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ567億8千8百万円減少し、2,788億5千9百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資357億4千2百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ566億7千2百万円減少し、3,146億1百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ413億1百万円減少の699億8千7百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益1,176億4千2百万円、未収消費税等の減少794億8百万円、前受金の増加515億円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,008億6千5百万円、棚卸資産の増加753億6千4百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出134億5百万円により、前年同期の107億6千2百万円の支出に対し166億6千7百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払1,188億3千3百万円により、前年同期の659億8千1百万円の支出に対し1,191億5千万円の支出となりました。

## 【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	111,289	69,987
税金等調整前四半期純利益	138,033	117,642
減価償却費	7,934	9,724
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	△24,600	16,837
棚卸資産の増減額(△は増加)	△20,578	△75,364
仕入債務の増減額(△は減少)	△784	△10,656
その他	11,285	11,804
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,762	△16,667
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	4,955	△66
その他(固定資産の取得等)	△15,718	△16,601
財務活動によるキャッシュ・フロー	△65,981	△119,150
現金及び現金同等物に係る換算差額	587	9,042
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	35,133	△56,788
現金及び現金同等物の期首残高	265,993	335,648
現金及び現金同等物の四半期末残高	301,126	278,859
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	341,742	314,601

## (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年3月期の連結業績予想につきましては、前回発表時(2022年5月12日)の見通しを変えておりません。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	274,274	269,601
受取手形、売掛金及び契約資産	433,948	426,137
有価証券	97,000	45,000
商品及び製品	183,512	218,746
仕掛品	144,330	164,942
原材料及び貯蔵品	146,002	173,517
その他	129,796	62,223
貸倒引当金	△160	△199
流動資産合計	1,408,703	1,359,969
固定資産		
有形固定資産	223,078	238,342
無形固定資産		
その他	22,540	24,603
無形固定資産合計	22,540	24,603
投資その他の資産		
その他	241,434	225,344
貸倒引当金	△1,298	△1,348
投資その他の資産合計	240,135	223,996
固定資産合計	485,754	486,941
資産合計	1,894,457	1,846,911

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	120,908	119,115
未払法人税等	107,193	36,909
前受金	102,555	155,229
製品保証引当金	26,568	29,694
賞与引当金	44,871	24,717
その他の引当金	5,353	3,908
その他	61,129	80,340
流動負債合計	468,578	449,915
固定負債		
その他の引当金	6,402	4,107
退職給付に係る負債	62,533	62,174
その他	9,894	15,865
固定負債合計	78,829	82,147
負債合計	547,408	532,063
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	1,104,983	1,074,152
自己株式	△27,418	△27,118
株主資本合計	1,210,537	1,180,006
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	93,492	70,849
繰延ヘッジ損益	△52	△68
為替換算調整勘定	30,640	48,958
退職給付に係る調整累計額	535	364
その他の包括利益累計額合計	124,615	120,102
新株予約権	11,895	14,738
純資産合計	1,347,048	1,314,847
負債純資産合計	1,894,457	1,846,911



## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
売上高	452,049	473,654
売上原価	241,118	273,126
売上総利益	210,931	200,528
販売費及び一般管理費		
研究開発費	34,356	42,122
その他	34,783	40,886
販売費及び一般管理費合計	69,140	83,009
営業利益	141,791	117,519
営業外収益		
受取配当金	841	1,069
持分法による投資利益	588	500
その他	351	752
営業外収益合計	1,781	2,322
営業外費用		
為替差損	683	1,772
その他	258	377
営業外費用合計	942	2,149
経常利益	142,630	117,692
特別利益		
固定資産売却益	0	0
特別利益合計	0	0
特別損失		
固定資産除売却損	20	49
付加価値税追徴税額	4,577	—
特別損失合計	4,597	49
税金等調整前四半期純利益	138,033	117,642
法人税等	37,669	29,547
四半期純利益	100,363	88,095
親会社株主に帰属する四半期純利益	100,363	88,095

四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
四半期純利益	100,363	88,095
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8,437	△22,639
為替換算調整勘定	1,663	18,145
退職給付に係る調整額	178	△167
持分法適用会社に対する持分相当額	68	148
その他の包括利益合計	10,348	△4,513
四半期包括利益	110,712	83,582
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	110,712	83,582

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ、及びウェーハレベルのボンディング/デボンディング装置などの半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置及び有機ELディスプレイ製造用インクジェット描画装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	464,003	9,614	7,953	481,571	△7,917	473,654
セグメント利益 又は損失(△)	133,596	△615	170	133,151	△15,508	117,642

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△15,508百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△6,667百万円、及びその他の一般管理費等であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。